证券代码：688381　　证券简称：帝奥微

江苏帝奥微电子股份有限公司
投资者关系活动登记表

2026 年 10 月

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议）
参与单位名称	建信养老、华西资管、中银基金、财通基金、国金证券、爱建证券等机构
时　　间	2026 年 9 月 23 日 、2026 年 9 月 24 日、2026 年 10 月 8 日
地　　点	线上交流、线下交流
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：鞠建宏 财务总监：成晓鸣 销售市场部高级副总裁：鲁慧锋 董事会秘书：王建波
投资者关系活动主要内容介绍	**1、 公司光模块目前有哪些产品？** 截至目前，公司已经围绕高速、高精度、高功率密度持续扩充光通信全系列模拟芯片产品矩阵。 信号链方面，公司推出多款具备行业突破性指标的光通信专用信号链产品，其中自研光模块专用模拟前端 AFE 产品实现 IDAC 性能重大突破，兼容 EML、硅光两类调制器，EML 驱动下 400mA 大电流叠加 120mV 极低 headroom，单通道省约 36mW 功耗，封装较主流方案紧凑 15%以上；硅光场景集成多通道 VDAC+IDAC，单芯片覆盖数据中心到城域多场景，完美适配光模块、CPO 共封装光学、硅光集成等下一代高速光传输场景；持续迭代量产业界首款超低漏电流（＜1nA）2GHz 超高速微弱信号采样开关，凭借极小漏电流特性有效抑制长距光传输基线漂移问题，大幅提升光信号接收端稳定性；同步完善多路电平转换、四刀双掷高速开关、集成 TVS 一体化过压保护开关、高速时钟扇出开关等配套器件，

	覆盖光模块信号采样、切换、电平匹配、静电防护全流程需求，构建起完整光通信信号链产品体系。 电源管理方面，公司陆续推出多款适配高功率、小型化光模块的电源新品，形成多层次、全覆盖的电源产品梯队：推出国内首款高精度大电流负载限流开关，集成高精度电流检测与分级限流保护，可精准管控光模块激光器、高速通道供电回路，规避过流损坏风险；量产 5V 1A/3A 集成叠封电感超小尺寸 DCDC 降压电源模块，采用先进合封工艺大幅缩减 PCB 占用面积，匹配光模块小型化集成趋势；完善 1.5A-3A 宽电流区间 TEC 控制器全系列产品，具备高精度温度闭环调节、高低温自适应补偿、多档功率可调能力，满足单通道、多通道激光器精准温控需求；同步迭代大电流升降压电源模块、多路负载开关，全面覆盖从低压小型低速光模块到 1.6T、CPO 等高功耗下一代高速光模块全功率段供电需求，形成包含降压转换、激光器精准温控、大电流通路限流保护、多通道电源分配的一站式光模块电源解决方案。 **2、光模块业务有哪些客户？进展如何？** 依托完整产品组合，公司光通信客户群体进一步扩大。目前公司的 AFE、模拟开关、TEC 驱动、负载开关等多款产品已经进入了海内外多家光模块厂商中。 **3、除光模块之外，公司在 NPO、CPO 有相关规划嘛？** 公司已经布局 4 路 IDAC 每通道支持最大 500mA、支持 12 路 VDAC 的 AFE；5V 6A 高效率集成电感式降压转换器；超小尺寸高效率 1.5A/3A TEC 等多款产品，覆盖 CPO、XPO/NPO、高速硅光等下一代高速光模块核心架构。同时配套大电流负载开关、升降压电源、高精度电流检测、电平转换器、模拟开关、高性能 LDO 等信号链与电源管理器件，形成完整的模拟芯片产品矩阵，可满足 800G、1.6T 及以上速率光模块对高精度偏置调控、温控闭环、多路电源供电、信号接口转换的设计需求，能够为新一代共封装及轻量化光学引擎提供全套国产模拟芯片选型支持，

	加速下一代 AI 算力高速互联光模块的产品落地与规模化量产。 公司近期还新推出了高集成度的同步 Buck-Boost 电源模块，它是集成功率电感的 Buck 电源，芯片与电感封装一体。无需板载独立电感，精简 BOM、降低物料成本，节省 PCB 面积、简化布线；依托 SiP 缩短功率回路，环路稳定、纹波低，同规格下转换效率达到国际同类产品先进水平，适配高速光模块狭小空间 POL 供电，实现电源小型化与国产替代。 **4、公司 OCS 相关产品进展如何？** 公司推出了 OCS 端高压 DAC 芯片，为 32 通道 14bit，输出电压覆盖 50-200V，精准驱动 MEMS 微镜，匹配超算集群骨干交换需求。目前这款产品已经送至客户验证测试,截止目前测试进展顺利。 **5、除上述产品外，公司在光通信业务还有哪些布局规划？** 公司力争成为全光通信解决方案的供应商，已经布局了涵盖光模块、CPO、XPO/NPO、OCS 相关的全链条模拟芯片。进一步公司已经开招研发岗推进 TIA 研发，补全接收端跨阻放大器，形成“发-收-控-供”完整模拟芯片能力矩阵，进一步夯实光通信业务布局，打开长期成长空间。 **6、公司产能情况如何？** 公司目前已经和多家晶圆代工厂商达成了长期稳定的合作，以稳定公司的产能供应。公司自身已储备 3-4 个月的战略库存，可应对短期需求波动。同时，针对高增长、对需求响应速度要求高的市场，公司已经与部分晶圆厂商合作，提前进行了 12 寸产线布局，丰富公司的产能供应结构。 **7、关于市场 FCC 限制传闻，请问对公司目前影响如何？** 公司注意到市场关于 3.2T 光模块可能面临相关监管的讨论。截至目前，公司未收到相关官方规则文件，也未收到客户就此提出的要求；相关规则尚未正式出台，目前对公司业务进展没有产生负面影响。

	现阶段公司主要为客户 800G、1.6T 光模块提供解决方案，3.2T 技术路线尚未定型。因此目前没有影响。 同时从 BOM 角度看，公司模拟芯片内嵌于光组件内部，单品占比相对不是很高，不会在原产地清单单独列示，因此公司预计几乎不会对市场热议的 65%美料占比核算产生影响。 从客户端沟通了解，也未提及 FCC 限制相关要求，公司的产品目前都有序向客户导入出货中。